For powerful future

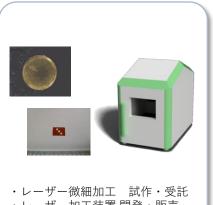
『デジタルテクノロジー と データサイエンス で モノづくり を加速』

デジタル情報技術を活用し、より力強い未来を作る

製造業を取り巻く環境は、時々刻々と厳しさを増しています。かつては技術大国として世界の トップランナーであった日本が、世界的な技術発展、海外での廉価な製品の普及や、国内の少子高 齢化による人材確保や技術伝承の難しさ、市場の縮小等により苦しい立場にあるようです。

DiNOV株式会社は、デジタル情報技術を融合させたテクノロジーで、これらの問題を解決して日 本の製造業、さらに日本の経済を活性化していきます。

デジタル・ファブ事業



- ・レーザー加工装置 開発・販売
- ・3Dプリント 試作・受託
- ・コンサルティング

デジタル・ コミュニケーション事業



- ・データ通信関連システム開発
- ・社内インフラ整備・保守・運用
- ・コンサルティング

データサイエンス事業



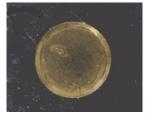
- ・AI (人工知能)を用いた システム開発
- ・AIによる製造業支援
- ・データ収集
- ・アノテーション・モデル開発

企業概要

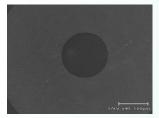
 社 名	DiNOV 株式会社 (英文社名 DiNOV Co., Ltd.)
所在地	〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-21 さがみはら産業創造センターSIC-1 1318
設立	2021年9月
資本金	300万円
代表取締役	出島秀一 Ph.D
事業目的	・デジタル・ファブ事業 ・デジタル・コミュニケーション事業 ・データサイエンス事業



デジタル・オンデマンド加工が可能なレーザーを用いる微細加工の試作開発・受託加工



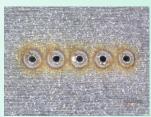
微細穴加工



タングステン穴加工



SUSへの超微細穴加工



SUSへの超微細穴加工



銅箔への微細穴加工



微細ディンプル加工



アルミへの微細深穴加工



極細メッシュ加工



精密深穴加工



セラミック溝加工



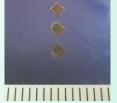
ポリイミド切断



SUSへの精密スリット加工



A5052への微細溝加工



PI切断



樹脂の精密切断

微細レーザー加工機

Products

高品質精密加工を実現するレーザー微細加工機の開発・販売

dinoCOMPACT

コンパクトなデスクトップ タイプの微細レーザー加工機

dinoSCRIBE

フルスペックのスタンドアロン タイプの微細レーザー加工機





